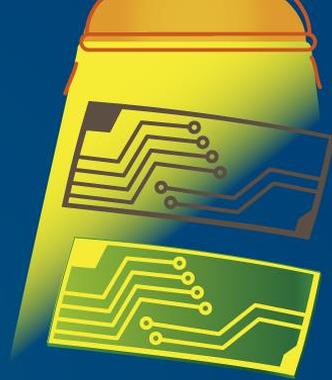


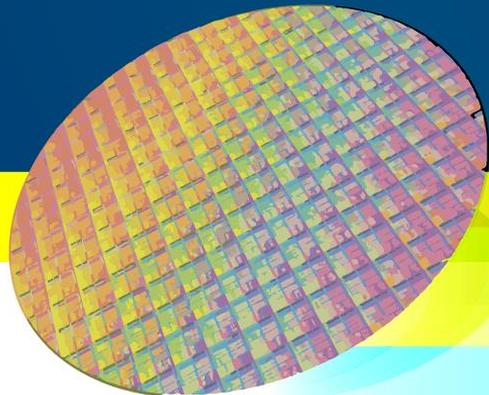
C SUN



志 聖 法 人 說 明 會

2467.TT

Investor Conference



Morrison Liang, Chairman

Jamie Wu, Co-head

Kent Chen, Co-head

Venue: Taiwan Stock Exchange Taipei 101

October 27th, 2020

This presentation contains some forward-looking statements that are subject to substantial risks and uncertainties. Typically, these statements contain words such as “anticipate” , “believe” , “could” , “estimate” , “expect” , “intend” , “plan” , “forecast” , “project” , “predict” , “potential” , “continue” , “may” , “should” , “will” , and “would” or similar words. You should consider these forward-looking statements carefully because such statements are only our expectations or projections about future events, and actual results may differ materially from those expressed or implied by such statements. The forward-looking statements in this presentation include, but are not limited to, growth rates for various markets estimated by third party sources, future products and technology development, widespread market acceptance of the hosted delivery model, future revenue growth and profitability. You should be cautioned that the forward-looking statements are no guarantee of our future performance. The forward-looking statements contained in this presentation are made only as of the date of this presentation and we undertake no obligation to update the forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, except as required by law.

This presentation and the information contained herein are the property of CSUN MFG. Ltd. **Neither this presentation nor any of its contents may be reproduced to a third party without the prior written consent of CSUN MFG Ltd.**

- 2020 Q3 營運成果
- 市場機會與產品發展
- Q&A

2020Q3營運成果

2020 Q3 營運成果

C SUN

5
in TWD millions

	2020Q3 累計	2019Q3 累計	2019	2018	2017	
Revenue-Consolidated	2,750	3,368	4,438	5,700	5,003	
COGS	↓18.4%	2,384	70.8% 3,170	71.4% 3,902	68.5% 3,345	66.9%
Gross Margin		985	29.2%	28.6% 1,798	31.5% 1,658	33.1%
Operating Expense		756	22.4%	21.5% 954	19.6% 1,119	21.8%
Operating Income		229	6.8%	7.1% 314	11.9% 679	11.3%
Net Income before tax		371	11.0%	9.4% 418	13.8% 785	10.3%
Net Income after tax	↑11.6%	287	8.5%	7.6% 338	10.5% 598	8.5%
Attribute to stockholder's of the parent	299	268	8.0%	7.0% 312	9.8% 556	8.1% 403
ROE		10.00%	11.64%	21.83%	18.20%	
EPS (NT\$/after tax)	\$2.01	\$1.80	\$2.09	\$3.73	\$2.70	
Debt Ratio		59.50%	58.66%	58.23%	59.81%	

市場機會 & 產品發展

-G2C聯盟(C SUN、GPM、GMM)優勢結合

-2019-2021開發產品與市場狀況: 半導體產業

印刷電路板產業

顯示器產業

2467
c sun
志聖

tcf
創峰

5443
GPM
均豪

6640
GMM
均華

UTRON
祁昌

- 深耕不同產業、互補性高
- 整合不同領域核心技術，整線規劃能力強
- 工程能量充足，聯盟成員**1,618**名，研發人力**529**名(占比**33%**)

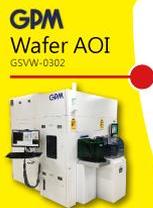
合力共創 同行致遠

G₂C

Go Go Champion
Great to Customers

SiP Process Equipment System in a Package

系統級封裝



Sputter

Wire Bond

Wafer Mount

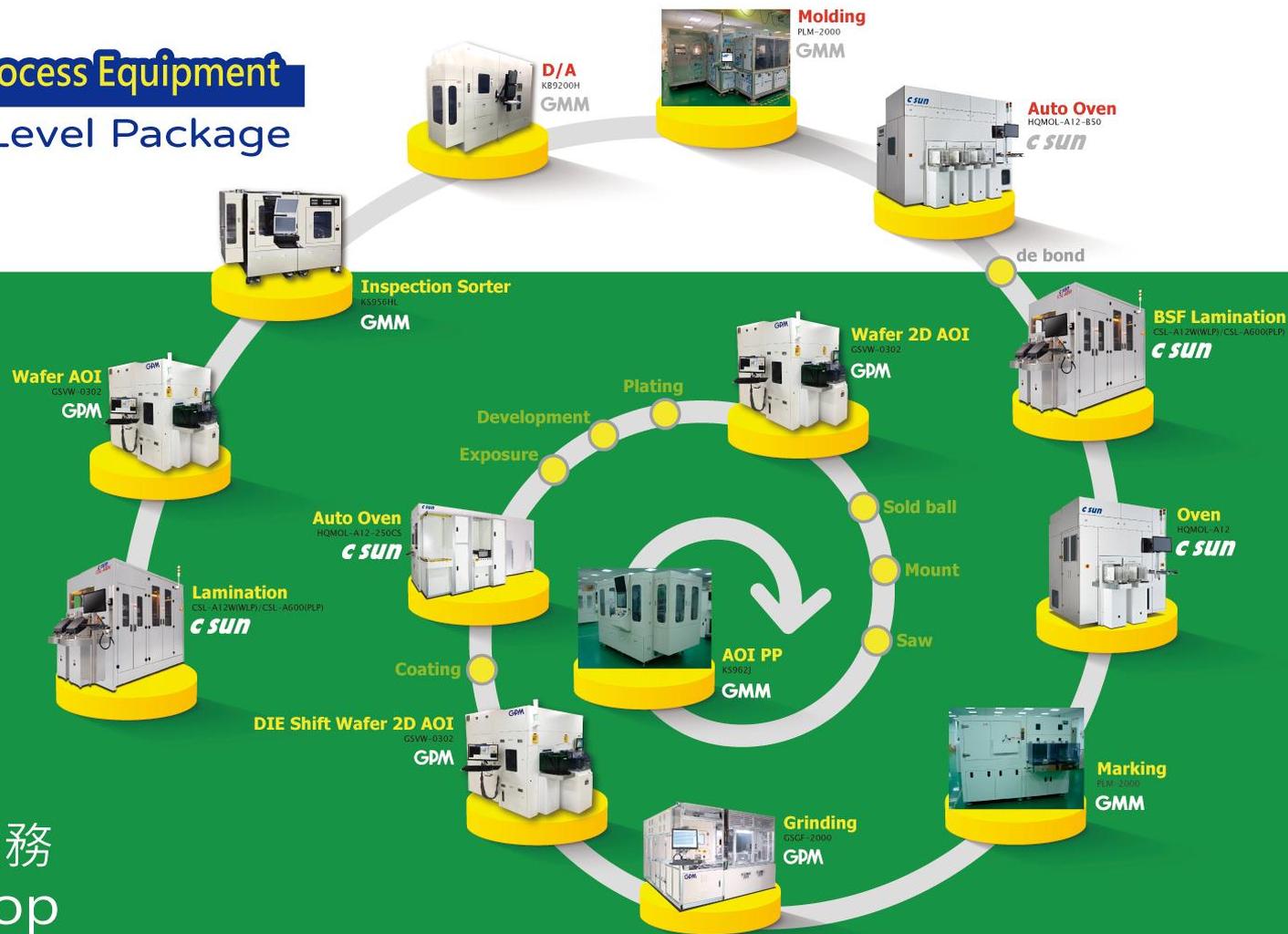
Wafer Saw

G2C 一站式服務
One Stop Shop

Fan Out Process Equipment

Fan Out Wafer Level Package

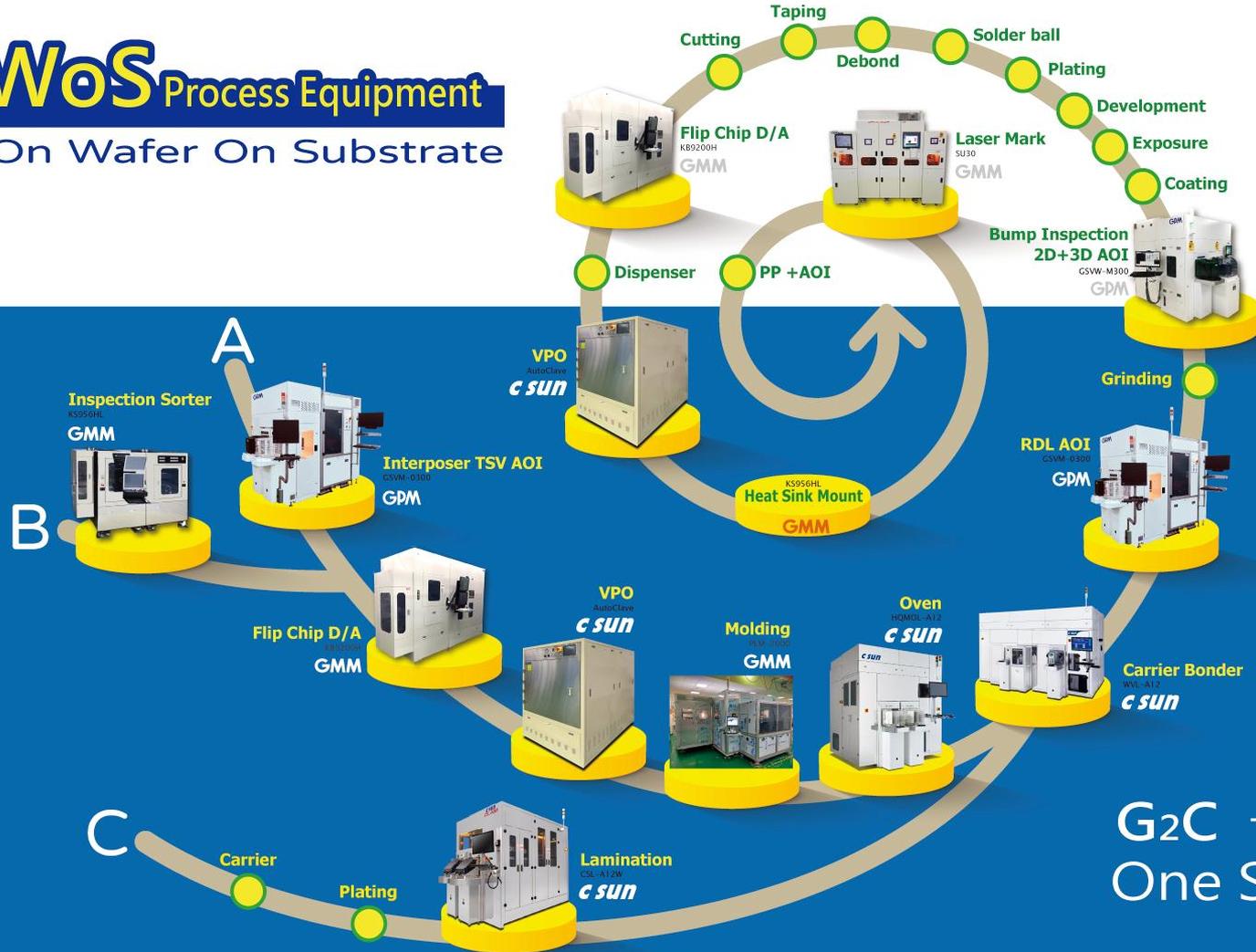
扇外型封裝



G2C 一站式服務
One Stop Shop

CoWoS Process Equipment

Chip On Wafer On Substrate



G2C 一站式服務
One Stop Shop

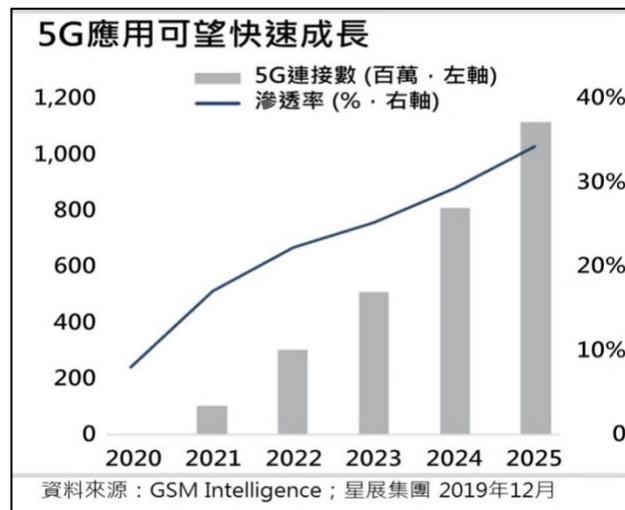
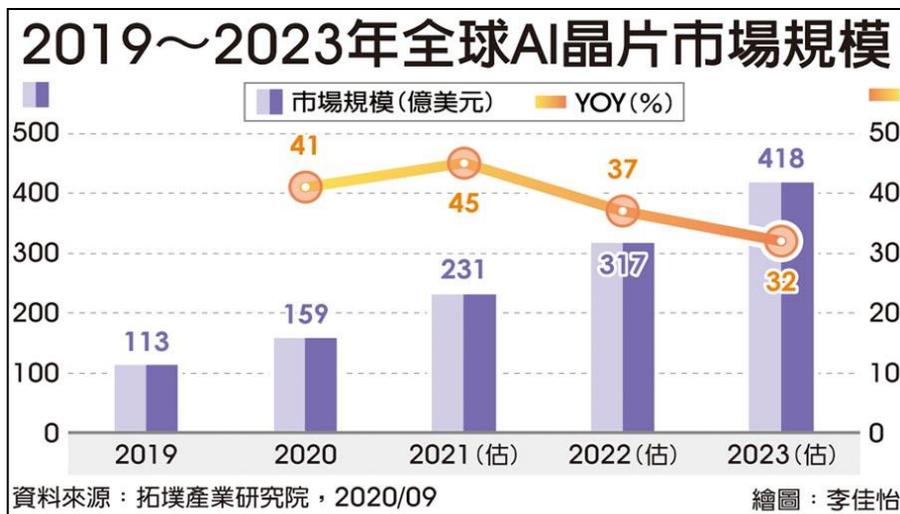
市場應用/產業發展

- 台灣半導體產業鏈完整在全世界佔有重要地位
- 中美貿易戰造成生產區塊變化明顯(台灣投資擴大)
- 半導體產業鏈上下游整合態勢，台灣先進封裝擴展速度加快
- 志聖兩岸各兩廠 充分掌握商機



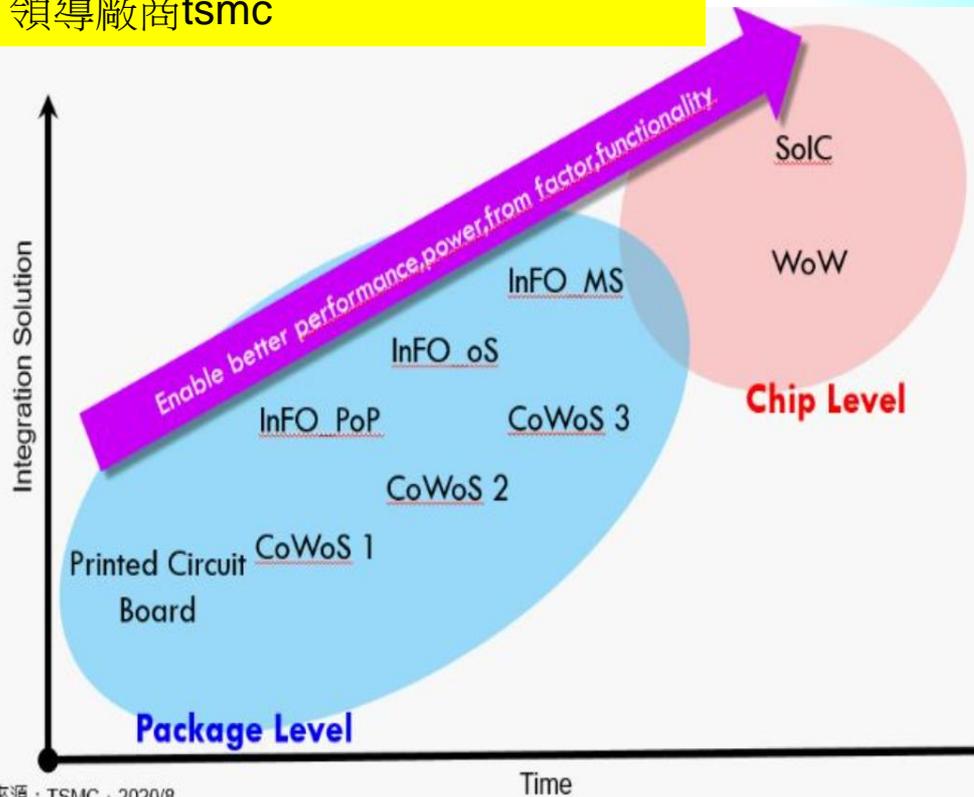
市場應用/產業發展

- 先進封裝加速5G、AIoT晶片需求成長
- 5G通訊、AI應用、自駕車技術方向明確
- 驅動IC產能瓶頸，COF封裝供不應求



2020~2021先進封裝技術趨勢

高階先進封裝製程走向Chip level→
領導廠商 tsmc



TSMC 3DFabric™

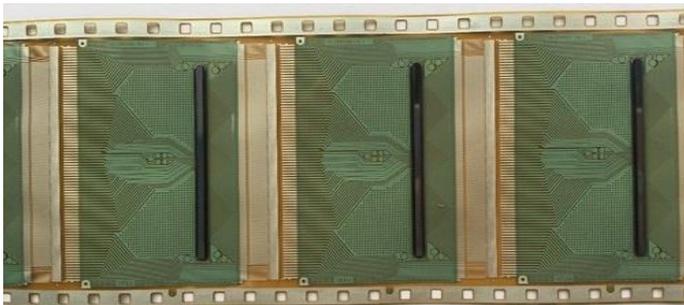


SoIC: System on Integrated Chips



InFO: Integrated Fan-Out
CoWoS: Chip on Wafer on Substrate
RDL: Redistribution Layer
LSI: Local Si Interconnect

- 全自動化高階非接觸式Roll to Roll 烘烤生產線已打入中國供應鏈。
- 產品應用: COF、軟板、軟性顯示器、軟性電子
- Q1已交機，客戶持續下訂單中

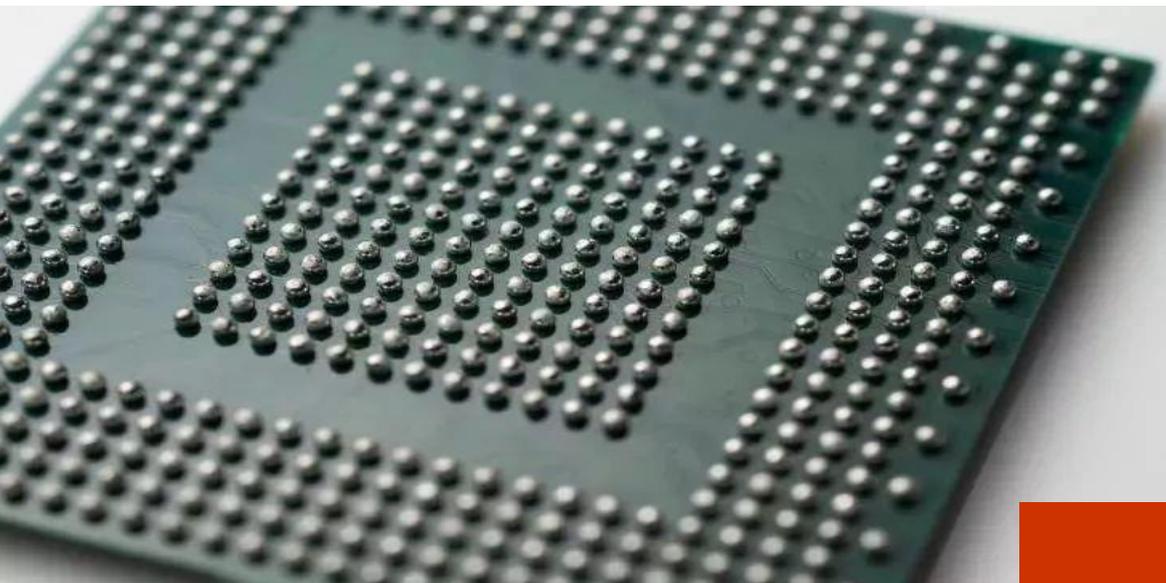


3D封裝脫泡製程- VPO(Vocuum Presshre Oven)

c sun

16

- 對應Chip on wafer脫泡、 μ bump等脫泡製程
- 已交貨到封裝大廠S公司、C公司，持續推廣中
- Q3通過DRAM大廠多層堆疊脫泡驗證，導入對應OHT系統的自動化VPO設備



真空+壓力混合型 Oven

射頻模組整合趨勢：功率放大器 / 濾波器整合



晶圓滾輪壓膜機



晶圓撕膜機

- 扇外型封裝 (Fan-Out) RDL製程的真空壓膜、烘烤自動化線
- 晶圓真空壓膜設備進入T社量產前準備並著手repeat order, 切入SoW製程base line
- Burn in Auto Oven 已交大陸DRAM廠驗證通過，洽談新項目中



晶圓真空壓膜機



Burn in AUTO OVEN

- 2.5D TSV 先進封裝生產規模隨AI晶片應用面擴大,持續放量
- 3D TSV 進入量產階段,規格更貼近前段要求,生產規模更甚前者,預估五年內兩位數設備需求



Auto oven



先進封裝未來新戰略:
高潔淨環輻爐管



Carrier Bonder

- IC載板及HDI板加速建廠
- 5G 伺服板
- Mini LED基板進入大量產



- IC載板/類載板及HDI高階設備規格封裝化
- ABF製程設備需求持續增溫



超薄板高階壓膜機



多腔真空壓膜線(ABF)



ABF剝膜機

- 5G基地台及雲端機房伺服器板須求大增
- 積極拓展軟板市場(LCP)



全自動曝光機



RTR全自動曝光機



RTR全自動壓膜機

Mini LED基板進入大量產

c sun

23

隨著智慧型手機大量改採mini LED作為背光用途，
推升需求持續爆發



全自動真空壓膜線



全自動滾輪壓膜機



全自動單面剝膜機

TCF 創峰
TOP CREATION



成熟產品、市佔第一

- 5G 通訊、高頻高速
- 汽車電子、高信賴性
- 軟板市場、輕薄細密
- 擴產轉型、工業 4.0

5G建設及產品應用
帶動產值倍數成長

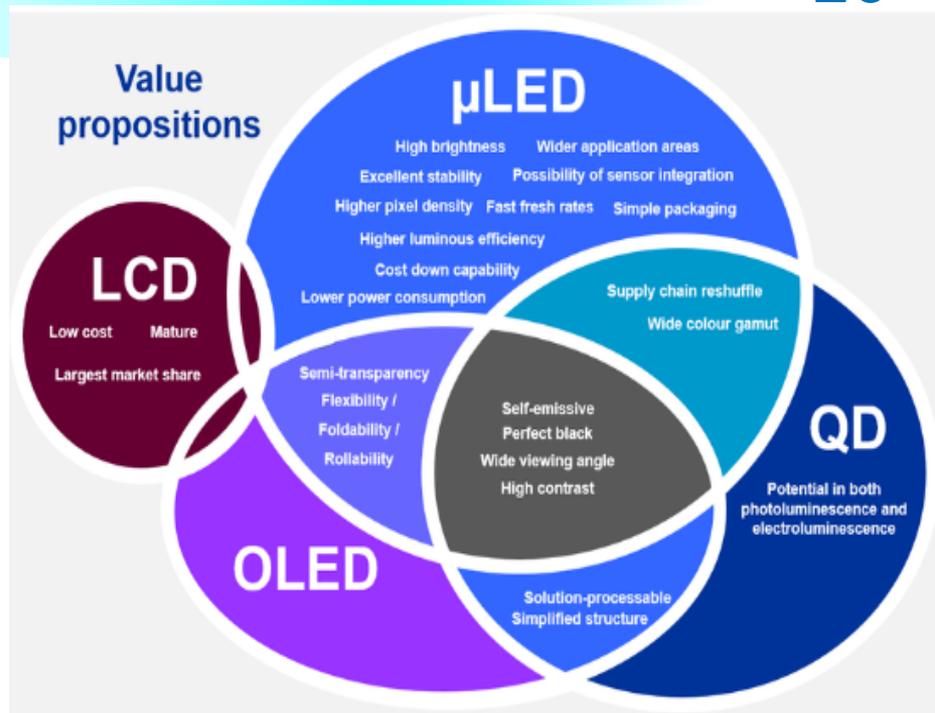


IC Substrate 超薄板設備推廣

- 優化垂直設備、商品化市場推廣



- 大陸客戶G10.5、G8.6 TFT/OLED建廠趨緩
- 高階車載模組大尺寸化應用 (3D曲面)
- Mini LED/Micro LED製程
- 電競面板需求促成高階製程導入



- 台灣車載面板擴線、改機需求持續
- Q2 I社車載面板模組自動化線、Q3 H社車載面板老化線訂單。今年已取得車廠專線訂單。
- 2020/Q4壓膜技術導入車載面板貼合製程

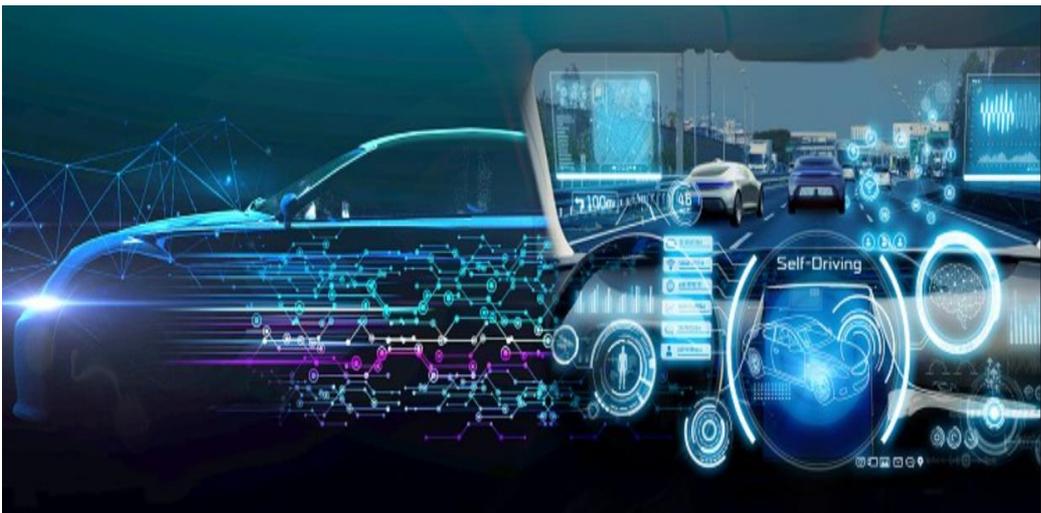


車載面板老化線



車用面板貼膜設備

- 車用面板高階保護玻璃防眩與抗指紋層烘烤線
- 已交日本玻璃大廠A社，Q3~量產製程驗證中
- 與陸資大廠洽談合作專案中



- Mini LED背光應用漸佔高階面板一席之地
- Micro LED實驗線陸續導入，為量產前置準備
- 玻璃基板製程陸續導入烘烤、UV、Plasma設備於產線應用
- Q2接獲磊晶大廠應用plasma於mini LED清潔去殘膠設備訂單
- Q4氣氛爐導入Micro LED RD line



電競面板需求持續

C SUN

30

2020年電競液晶顯示器出貨量上看1,220萬台
相較2019年成長37%

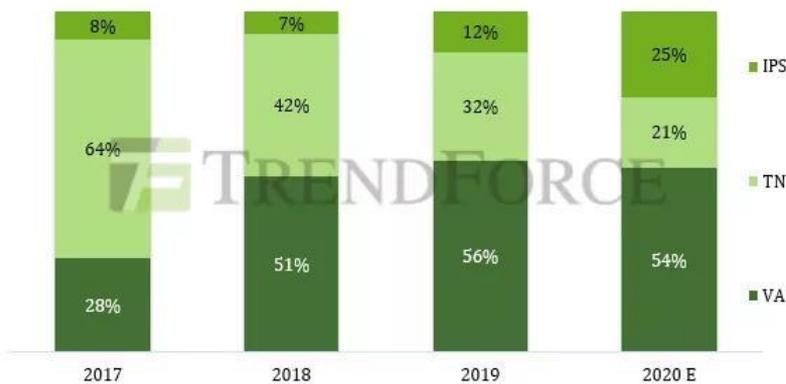
IPS、VA技術不斷進度，衍生新設備需求



年度	2020年		2024年		年複合成長率 (%)
	出貨量 (萬台)	ASP (美元)	出貨量 (萬台)	ASP (美元)	
電競桌機	1,480	699	1,580	671	1.6
電競螢幕	1,240	348	1,600	341	6.4
電競筆電	2,230	967	3,020	955	7.9
總量	4,960	-	6,190	-	5.7

資料來源：IDC，2020/9
整理：翁毓嵐

圖一、2017年~2020年电竞液晶显示器面板类型比例



Source: TrendForce, Jul. 2020

- G2C合作平台創造設備整合價值。
- 緊跟代工大廠T社先進封裝資本支出。
- 系統級封裝應用廣泛持續耕耘封裝大廠A社、C社資本支出資本支出。
- IC載板、mini LED應用持續擴張，台資廠投資多。
- 伺服板HDI需求量上揚，設備資本支出多。
- 大陸G10.5、G8.6建廠持續。
- 高階車載模組大尺寸化，衍生車廠專線需求。

Q & A

IMF最新亞洲成長預測



	2020年	2021年
亞洲	-2.2%	6.9%
中國	1.9%	8.2%
台灣	0.0%	3.2%
韓國	-1.9%	2.9%
日本	-5.3%	2.3%
新加坡	-6.0%	5.0%
香港	-7.5%	3.7%
印度	-10.3%	8.8%

資料來源：IMF 10月報告 整理：蕭美惠



G2C聯盟 共同捐贈清大樹人基金

c sun

35





Thank You